

电子

每周专题：集成电路的两次戴维斯双击！

上周半导体板块大涨，引领板块反弹，科技是明确主线。上周申万半导体指数大涨 17.99%，年初至今涨幅达 52.75%，我们前期已经多次阐述芯片之于国家产业重要性，芯片兴则产业兴，芯片兴则经济兴，战略必争之地，科技是明确主线。

第一次戴维斯双击：龙头公司率先受益需求回暖，叠加科创板带来的对科技类公司的风险偏好提升将在一季度形成第一次戴维斯双击。从1月初我们两百页消费电子、半导体深度报告看 19 年代际切换、年中产业拐点以来，产业迎来全面修复，对手机创新、半导体产业拐点预期逐步加强。科创板方面，集成电路位列第一，目前部分优质龙头已接受 IPO 辅导，中微半导体、澜起科技等预计第一批挂牌，有望进一步支持优质半导体企业快速发展。

第二次戴维斯双击：年中半导体产业回暖以及相应的预期修复将形成第二次戴维斯双击。我们最早《全球半导体代际切换、先抑后扬、年中有望反转》逐步得到产业和市场认同，从市场调研来看，需求逐步恢复，预期逐步加强！龙头兆易创新、韦尔股份、三安光电、北方华创等自身产品及客户都进入收获期，叠加市场需求回暖有望逐步迎来拐点，而 mlcc、二极管、功率半导体等价格开始涨价，数据中心 google、阿里、华为等开始追加建设，需求逐步回暖，渠道去库存有望季度末进入尾声，全球半导体周期回暖，而从需求端看，手机、5g、大数据、人工智能、汽车、物联网等需求在 19 年上半年代际切换后，下半年进入新成长期，这轮半导体从底部启动，时间和空间都有望超上一波！

推荐重点配置半导体、5G、有业绩保障的消费电子。半导体：存储：兆易创新；模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子；数字芯片 GPU：景嘉微；AP：北京君正、全志科技；IDM：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子；化合物半导体：三安光电；设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技；材料：兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子；封测：长电科技、华天科技、通富微电；安防：海康威视、大华股份、千方科技；消费电子：立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信；PCB：深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技；5G 相关：深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技；面板以及相关：京东方、劲拓股份、濮阳惠成；元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子。

风险提示：下游需求不及预期、宏观环境边际恶化。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 郑震湘

执业证书编号：S0680518120002

邮箱：zhengzhenxiang@gszq.com

研究助理 余凌星

邮箱：shelingxing@gszq.com

研究助理 徐斌毅

邮箱：xubinyi@gszq.com

相关研究

- 1、《电子：边缘计算，万亿芯片新空间》2019-03-10
- 2、《电子：潜望式镜头来袭，开启光学变焦的新篇章》2019-03-06
- 3、《电子：科创板正式登场，集成电路成重中之重》2019-03-03



内容目录

一、每周专题	3
1.1 科技是明确主线	3
1.2 一季度第一次戴维斯双击：龙头拐点+科创板	6
1.3 年中第二次戴维斯双击：产业回暖+预期修复	9
二、投资组合推荐	11
三、本周行情回顾	11
四、半导体行业动态	13
风险提示	14

图表目录

图表 1: GDP 与各大产业增加值对比 (亿美元)	3
图表 2: 全球 GDP 增速 vs 全球电子系统市场增速	3
图表 3: 全球电子系统市场增速 vs 全球半导体市场增速	4
图表 4: 《中华人民共和国专利法修正案(草案)》主要内容	4
图表 5: 中国集成电路领域专利增长趋势	5
图表 6: 我国集成电路布图设计专有权 (2006 年到 2016 年)	5
图表 7: 中国主要集成电路领域公开专利主要权利人 (1985-2017)	6
图表 8: 一张表看懂科创板与主板、中小板、创业板的区别	7
图表 9: 科创板推进进程	8
图表 10: 有望首批登陆科创板的公司	9
图表 11: Wind 一致预期显示半导体板块预期率先修复 (单位: 亿元)	10
图表 12: IDM 板块库存情况	10
图表 13: 设计板块库存情况	10
图表 14: 代工板块库存情况	11
图表 15: 渠道公司-艾睿电子库存情况	11
图表 16: 申万一级行业周涨跌幅	12
图表 17: 电子行业指数相对沪深 300 表现	12
图表 18: 细分行业周涨跌幅	13

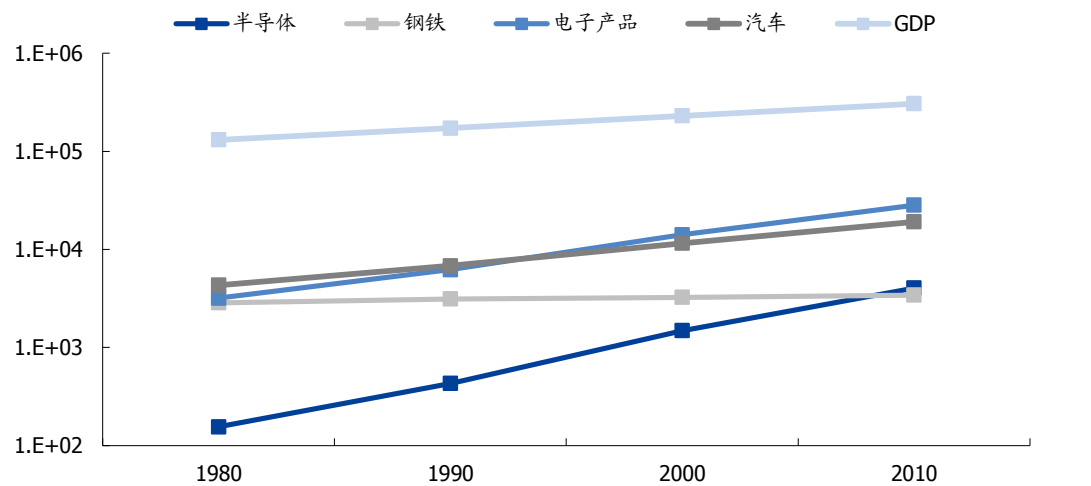
一、每周专题

1.1 科技是明确主线

上周半导体大涨，引领板块反弹，科技是明确主线。上周申万半导体指数大涨 17.99%，年初至今涨幅达 52.75%，我们前期已经多次阐述芯片之于国家产业重要性，芯片兴则产业兴，芯片兴则经济兴，战略必争之地。

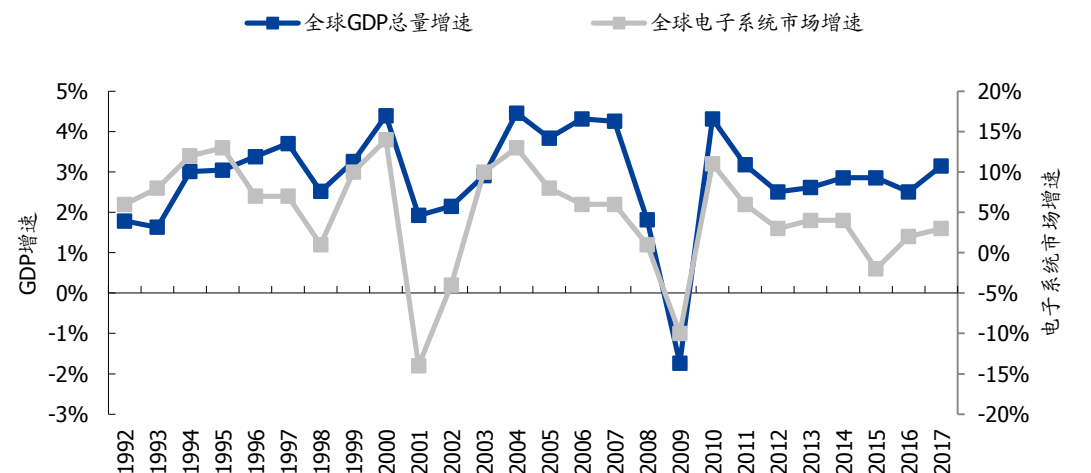
科技对发展的支撑作用如何体现？科技是核心竞争力，发展半导体产业是掌握科技话语权的必经之路。从全球 GDP 与各大产业增加值来看，1980 年以来，半导体产业迅猛发展，相较于钢铁、汽车等传统产业，半导体增加值曲线斜率相对较高，且半导体产业增加值已超过钢铁产业增加值，以集成电路为主的半导体产业对 GDP 的贡献率稳步提升。从增速来看，全球电子系统、半导体市场规模增速与 GDP 增速高度相关，其中电子系统增速与 GDP 增速差距逐渐缩小，而半导体增速则始终保持相对较高水平。

图表 1: GDP 与各大产业增加值对比 (亿美元)



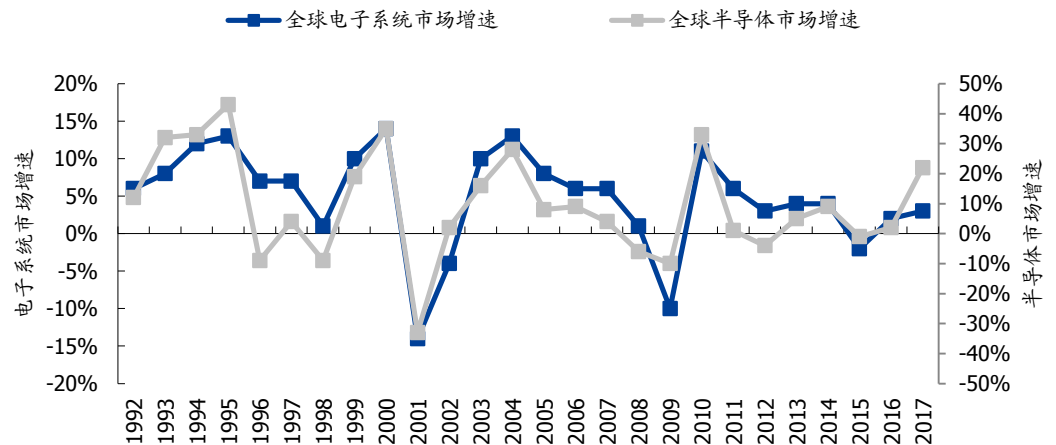
资料来源:《微电子学概论》、国盛证券研究所

图表 2: 全球 GDP 增速 vs 全球电子系统市场增速



资料来源: IC Insight、国盛证券研究所

图表 3: 全球电子系统市场增速 vs 全球半导体市场增速



资料来源: IC Insight, 国盛证券研究所

什么是硬科技? 集成电路有多硬? 我们看一组研发投入数据, 研发投入才是硬实力, 能为未来科技发展提供内生源动力。1) 以申万一级行业来看, 18H1 研发投入占营收比重中, 排名前三位分别是计算机、电子、通信, 电子行业研发投入排名第 2 位。2) 选取排名前两位的子行业观察, 半导体行业研发投入排名第 1 位, 计算机应用排名第 2 位, 且由于应用环节涉及到较多的“软”科技, 我们认为, 半导体排名第 1 位的“硬科技”属于当之无愧。随着科创板的日益临近, “硬科技”之王半导体产业将受到资本市场前所未有的全方位支持, 我们认为是一件利于产业长期健康发展的大好事。

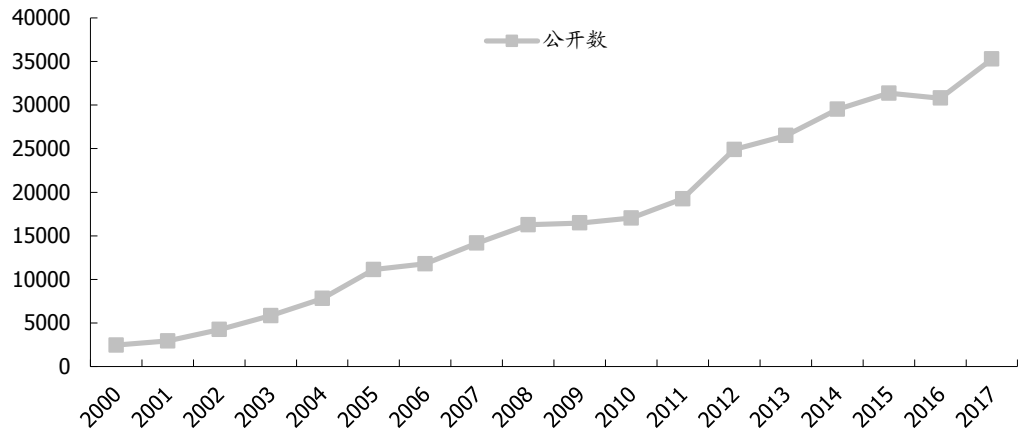
中国集成电路专利数量快速增长, 专利法修正案利好国产半导体。 美国集成电路相关专利数量增长自 2002 年达到顶峰, 互联网泡沫破裂之后逐渐下滑, 而中国相关专利自 2000 年以来长期保持快速增长, 2017 年有加速增长的趋势 (17 年申请数显示较少, 主要由于部分专利还未公开)。从专利结构来看, 设计相关专利数量在我国集成电路专利总量中排名第一, 而设计领域中, 模拟电路专利数量位居首位, 之后依次是处理器、逻辑电路、存储器。此次《中华人民共和国专利法修正案(草案)》获通过, 有大量专利布局、掌握核心技术的企业有望获益, 利好国产半导体行业。

图表 4: 《中华人民共和国专利法修正案(草案)》主要内容

序号	内容	详情
1	加大打击力度	借鉴国际做法, 大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额
2	明确举证责任	明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任
3	明确激励机制	明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制, 并完善了专利授权制度

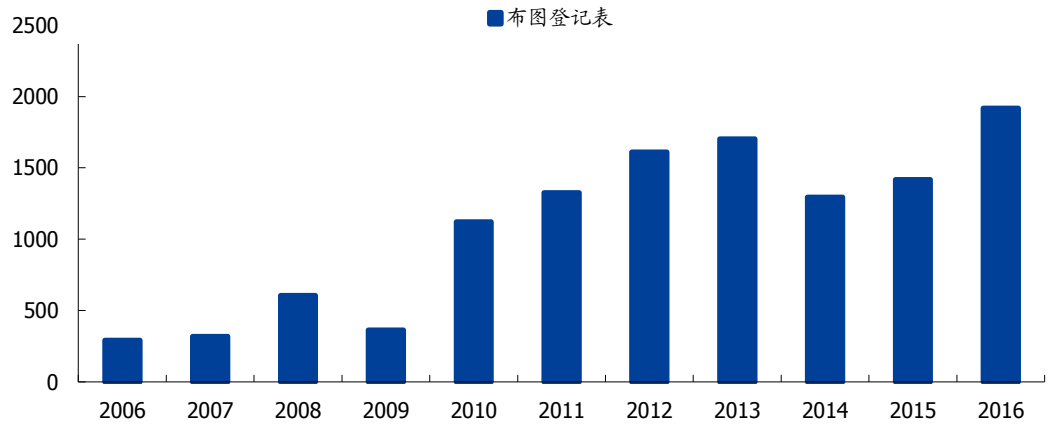
资料来源: 中国政府网、国盛证券研究所

图表 5: 中国集成电路领域专利增长趋势



资料来源:《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所

图表 6: 我国集成电路布图设计专有权(2006年到2016年)



资料来源:《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所

图表 7: 中国主要集成电路领域公开专利主要权利人 (1985-2017)

排名	公司	地区	专利数
1	中芯国际	中国大陆	6960
2	三星	韩国	6594
3	华虹集团	中国大陆	5230
4	松下半导体	日本	4203
5	华为	中国大陆	4200
6	台积电	中国台湾	3632
7	IBM	美国	3432
8	索尼	日本	3352
9	英特尔	美国	3221
10	中兴	中国大陆	3006
11	美国高通	美国	2546
12	中科院微电子研究所	中国大陆	2345
13	飞利浦	荷兰	2316
14	东芝	日本	2077
15	电子科技大学	中国大陆	1911
16	清华大学	中国大陆	1796
17	日本电气株式会社	日本	1664
18	富士通	日本	1646
19	鸿海	中国台湾	1624
20	半导体能源研究所	日本	1685

资料来源:《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所

1.2 一季度第一次戴维斯双击: 龙头拐点+科创板

从1月初我们两百页消费电子、半导体深度报告看19年代际切换、年中产业拐点以来,产业迎来全面修复,对手机创新、半导体产业拐点预期逐步加强。

我们认为,龙头公司率先受益需求回暖,叠加科创板带来的对科技类公司的风险偏好提升将形成第一次戴维斯双击。

SEMI 数据显示,ADI 中国区的 BB 值(订单/出货)由 Q4 的 0.8 回到 Q1 的 1.1,汽车和通讯一直稳定,主要改善来自于工业及部分消费电子,ADI 指标领先下游 2 到 3 个月,意味着下游 Q2 需求回暖确定;

上海证券交易所于 3 月 1 日正式发布实施科创板相关业务规则和配套指引,对红筹企业上市标准、股份减持制度、信息披露审核内容和要求以及督导职责边界做了新的更新和调整,但科创板 50 万资产门槛和 2 年证券交易经验门槛不变,T+1 交易机制不变。**2018 年 11 月 20 日**,上海市委书记李强在上交所主持召开座谈会时指出,科创板要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域。

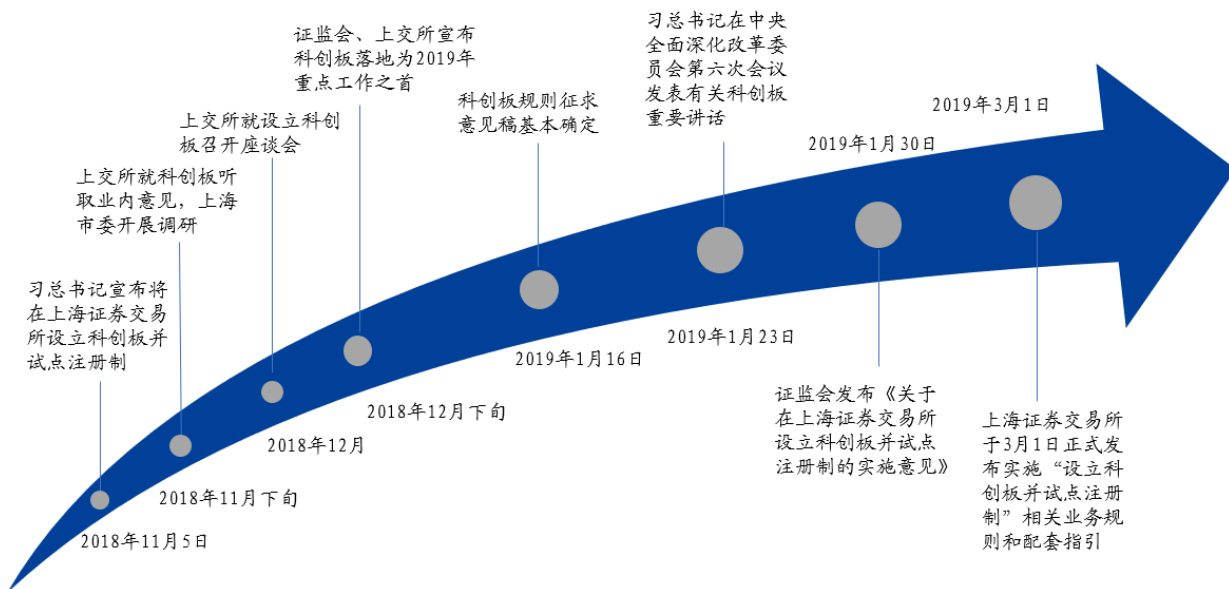
图表 8: 一张表看懂科创板与主板、中小板、创业板的区别

规定	主板及中小板	创业板	科创板
上市场所	主板(上交所、深交所)、 中小板(深交所)	深交所	上交所
市场类型	场内市场	场内市场	场内市场
存续时间	存续满三年	存续满三年	存续满三年
盈利要求	近三个会计年度净利润为正, 累计超过 3000 万元, 净利润以扣除非经常损失后较低者为计算依据	近两年连续盈利, 净利润累计不少于 1000 万元; 或近一年净利不少于 500 万元, 近两年营收增长率不低于 30%	预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元, 或预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
现金盪要求	近三个会计年度现金流累计超过 5000 万元; 或三个会计年度应收超过 3 亿元	无	预计市值不低于人民币 20 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元, 且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元。
股本盪求	发行后股本总额不少于 5000 万元	发行后股本总额不低于人民币 3000 万元	发行后股本总额不低于人民币 3000 万元。
市值要求	无	无	预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元, 或预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元; 预计市值不低于人民币 15 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元, 且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%; 预计市值不低于人民币 20 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元, 且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元; 预计市值不低于人民币 30 亿元, 且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元; 预计市值不低于人民币 40 亿元, 主要业务或产品需经国家有关部门批准, 市场空间大, 目前已取得阶段性成果。
主营业务要求	最近 3 年主营业务没有发生重大变化	发行人应当主业经营一种业务, 其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策及环境保护政策	发行人生产经营符合法律、法规的规定, 符合国家产业政策。重点支持五大行业。
上市审核	核准制	核准制	注册制
投资者门槛	一般投资者	原则上具有两年以上(含两年)股票交易经验的投资者	前 20 交易日日均股票资产 50 万, 两年交易经验。
股东人数要求	不少于 200 人	不少于 200 人	无
支持 VIE	否	否	是, 但市值要求高于一般企业。
涨跌幅限制	涨跌幅限制比例为 10%	涨跌幅限制比例为 10%	前 5 交易日不设涨跌幅, 之后 20% 涨跌幅限制。

资料来源: 搜狐科技、国盛证券研究所

2018年11月5日，习总书记宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。各大部门积极响应，科创板是资本市场的重大制度创新，经中国证监会批准后，正式向市场发布实施。

图表 9: 科创板推进进程



资料来源: 上交所、国盛证券研究所

科创板为电子领域企业尤其是集成电路带来了充分的机遇。科创板主要针对的企业来自五大行业领域，分别为：

- 第一类：新一代信息技术，包括**集成电路**、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等；
- 第二类：高端装备制造和新材料，主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床、机器人及新材料；
- 第三类：新能源及节能环保，主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保；
- 第四类：生物医药，主要包括生物医药和医疗器械；
- 第五类：技术服务领域，主要为**半导体集成电路**、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。

自2018年11月5日以来，上海证监局披露接受上市辅导的有十余家，具有登录科创板潜力，其中半导体领域的企业占比较大。根据2018年11月5日以来证监会上海局网站的IPO辅导备案公告、科创板的上市条件（上市条件详情见图表1）以及上海证券报的报道，我们筛选出了几家具有代表性的有望达成科创板“首班车”的半导体公司。

图表 10: 有望首批登陆科创板的公司

名称	所属领域	主要涉及产品
澜起科技	半导体	内存接口芯片
寒武纪科技	半导体	智能芯片
中微半导体	半导体	半导体设备
上海新晟半导体	半导体	半导体硅片
芯物科技	半导体	半导体技术、传感器技术、光电技术、物联网技术等领域的技术开发
苏州国芯	半导体	国产嵌入式 CPU
硅谷数模	半导体	接口芯片
安集微电子	半导体	半导体材料
晶晨半导体	半导体	芯片设计（影响影音处理芯片）
上海晶丰明源半导体	半导体	芯片设计（LED 照明驱动芯片）
聚辰半导体	半导体	芯片设计（EEPROM、智能卡、镜头驱动、运放）
上海微电子	半导体	集成电路设备（光刻设备、激光应用设备、光学检测设备和特殊应用设备）
乐鑫信息科技	半导体	芯片解决方案（无线通信芯片）
睿芯微电子	半导体	CMOS 图像传感器
东芯半导体	半导体	存储芯片（MEMORY）的研发及销售。
集创北方	半导体	显示控制芯片整体解决方案提供商

资料来源：国盛证券研究所根据证监会上海局网站的 IPO 辅导备案公告、科创板上市条件以及上海证券报整理

1.3 年中第二次戴维斯双击：产业回暖+预期修复

我们认为，年中半导体产业回暖以及相应的预期修复将形成第二次戴维斯双击。我们最早《全球半导体代际切换、先抑后扬、年中有望反转》逐步得到产业和市场认同，从市场调研来看，需求逐步恢复，预期逐步加强！龙头兆易创新、韦尔股份、三安光电、北方华创等自身产品及客户都进入收获期，叠加市场需求回暖有望逐步迎来拐点，而 mlcc、二极管、功率半导体等价格开始涨价，数据中心 google、阿里、华为等开始追加建设，需求逐步回暖，渠道去库存有望季度末进入尾声，全球半导体周期回暖，而从需求端看，手机、5g、大数据、人工智能、汽车、物联网等需求在 19 年上半年代际切换后，下半年进入新成长期，这轮半导体从底部启动，时间和空间都有望超上一波！

我们统计了不同时点行业对电子板块的业绩增长一致预期，以 2019 年 1 月 1 日与 2019 年 3 月 10 日为基准，可以看到，申万电子板块整体预期增速略有下滑，但半导体板块净利润预期增速大幅提升，由 1 月 1 日的 45% 提升至 3 月 10 日的 53%，提升 7.83 个百分点。

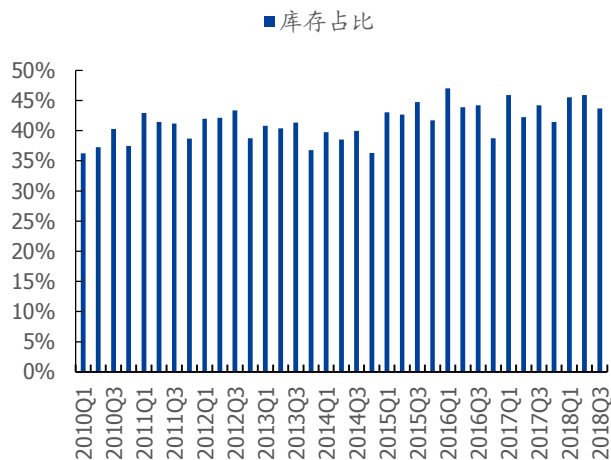
图表 11: Wind 一致预期显示半导体板块预期率先修复 (单位: 亿元)

预测日期	2019年3月10日			2019年1月1日			
	18年净利润 预期	19年净利润 预期	增速	18年净利润 预期	19年净利润 预期	增速	预期增速变化
SW 电子	990	1,257	27%	1,037	1,333	29%	-1.67pct
SW 半导体	58	88	53%	69	99	45%	+7.83pct
SW 集成电路	50	78	55%	59	86	47%	+8.60pct
SW 分立器件	5	6	30%	7	8	28%	+2.00pct
SW 半导体材料	3	5	49%	3	5	51%	-2.29pct
SW 元件 II	142	172	21%	146	185	27%	-5.81pct
SW 印制电路板	87	106	22%	87	115	32%	-9.72pct
SW 被动元件	55	66	19%	59	70	19%	-0.06pct
SW 光学光电子	256	326	27%	281	371	32%	-4.72pct
SW 显示器件 III	121	156	28%	137	182	33%	-4.75pct
SWLED	104	130	25%	114	147	29%	-4.10pct
SW 光学元件	30	40	31%	29	41	39%	-7.29pct
SW 电子制造	467	579	24%	475	594	25%	-1.04pct
SW 电子系统组装	327	388	19%	330	394	19%	-0.58pct
SW 电子零部件制造	140	191	36%	145	201	38%	-1.76pct
SW 其他电子 II	68	92	36%	66	84	27%	+9.40pct
SW 其他电子 III	68	92	36%	66	84	27%	+9.40pct

资料来源: Wind, 国盛证券研究所, 根据 1月1日及 3月10日 Wind 一致预期统计。

我们多次强调, 本轮半导体景气度下行的本质是在全球创新周期代际切换关键期遭遇贸易摩擦、宏观经济下行扰动需求后的库存调整。我们统计下来, 目前供给端库存水位较低, 行业回调主要由于渠道端去库存, 根据行业一般规律, 渠道端去库存一般将维持 2-3 个季度, 渠道基本从三季度起开始去库存 (也正对应部分原厂九月份订单下跌), 因此判断年中行业有望回暖。

图表 12: IDM 板块库存情况



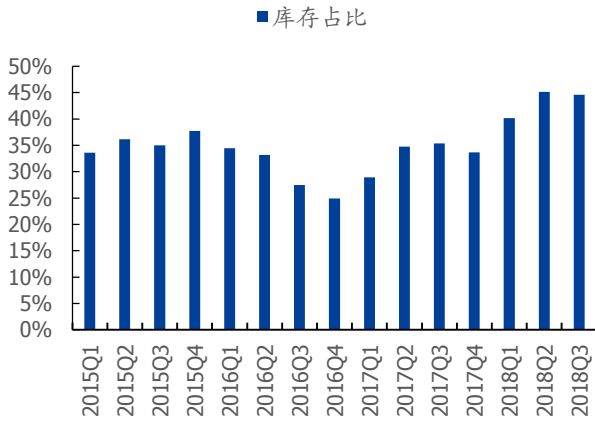
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 13: 设计板块库存情况



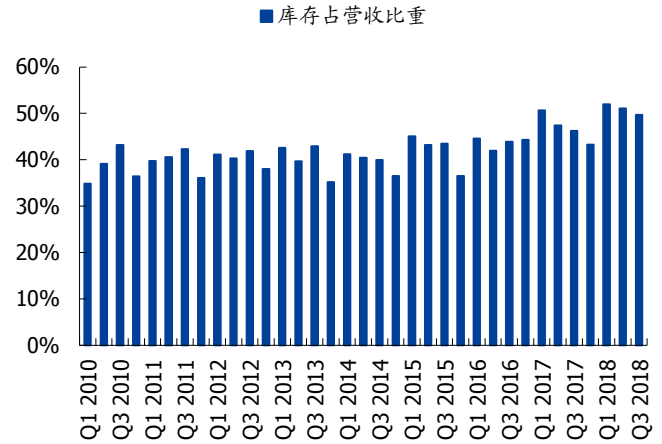
资料来源: Bloomberg, 国盛证券研究所

图表 14: 代工板块库存情况



资料来源: Bloomberg、国盛证券研究所

图表 15: 渠道公司-艾睿电子库存情况



资料来源: Bloomberg、国盛证券研究所

南亚科技总经理李培瑛接表示内存价格由于下游数据中心回暖, 下半年有望重新进入上升通道。结合科技需求未来三年的持续性成长、库存、capex 支出三大关键数据, 年中反转结论更加明确。

二、投资组合推荐

推荐重点配置半导体、5G、有业绩保障的消费电子。

半导体:

存储: 兆易创新;

模拟: 韦尔股份、圣邦股份、富满电子;

数字芯片 GPU: 景嘉微; AP: 北京君正、全志科技;

IDM: 闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子;

化合物半导体: 三安光电;

设备: 北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技;

材料: 兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子;

封测: 长电科技、华天科技、通富微电;

安防:

海康威视、大华股份、千方科技;

消费电子:

立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信;

PCB:

深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技;

5G 相关:

深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技;

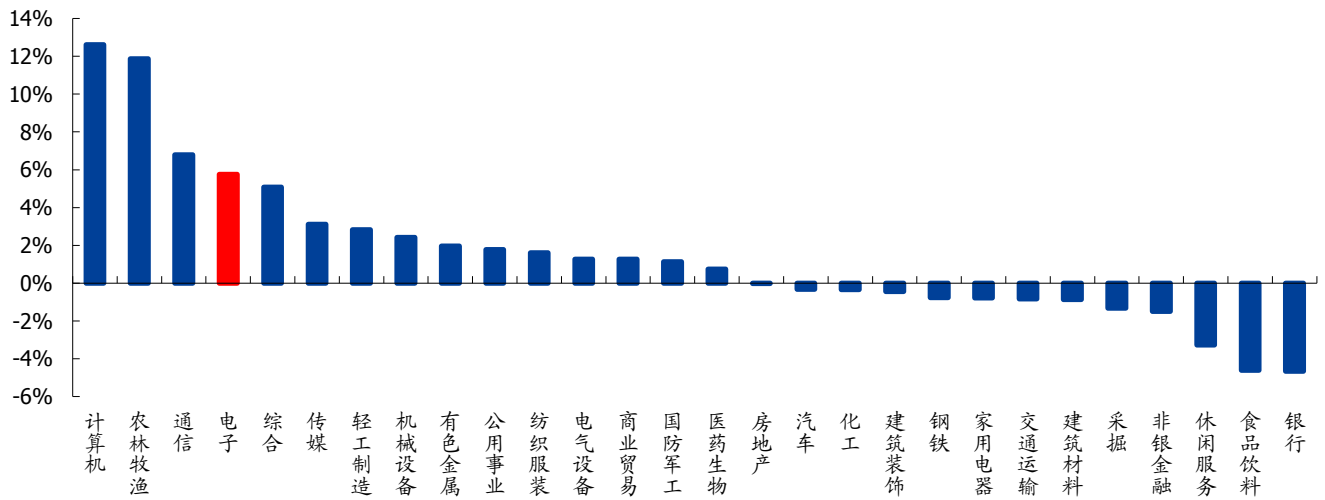
面板以及相关: 京东方、劲拓股份、濮阳惠成;

元器件: 火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子;

三、本周行情回顾

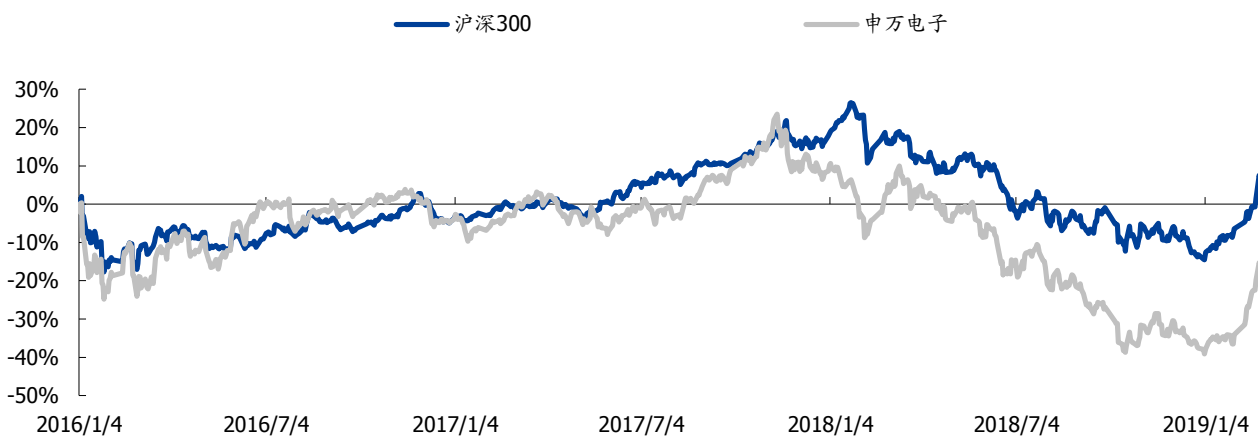
本周沪深300下跌2.46%，申万电子指数上涨5.75%，跑赢沪深300指数8.21个百分点，在28个申万一级行业中涨幅排名第4。

图表 16: 申万一级行业周涨跌幅



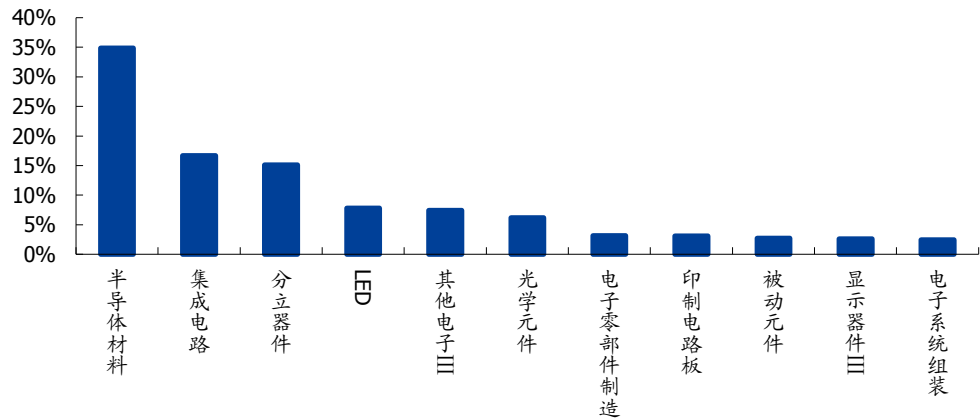
资料来源: Wind、国盛证券研究所

图表 17: 电子行业指数相对沪深300表现



资料来源: Wind、国盛证券研究所

图表 18: 细分行业周涨跌幅



资料来源: Wind、国盛证券研究所

四、半导体行业动态

华为上海巨型研发基地，正式启动

2019年伊始，华为上海研发基地一期土地正式出让，青浦继首届中国国际进口博览会盛事后再次成为全国焦点。华为上海研发基地体量巨大，占位青浦科创走廊建设的发展主轴，一期占地面积即高达94.7万m²！办公区总占地面积高达4000亩，是华为松山湖本部的2倍。华为上海研发基地投资规模比肩松山湖总部，总投资高达71亿元，年产值预计将达100亿元，势必成为华为全球领先的研发中心。

来源：半导体行业联盟

日本再生晶圆大厂 2018 年营收增 133%

周三(6日)日本再生晶圆大厂RS Technologies公布2018年度财报，表现超乎市场预期，计入北京子公司营收后的合并营收大增至257.78亿日元，年增133.1%；合并纯益则为36.2亿日元，年增率亦强升71.3%。RS Technologies在财报声明中表示，由于再生晶圆需求持续强劲，且日本、台湾工厂产能全开，带动公司整体业绩走扬，而展望2019年未来营运状况，RS Technologies则预期今年该公司全年合并营收成长将小幅成长，合并纯益则维持与去年持平的高位水平。

来源：钜亨网

三星宣布量产 eMRAM，嵌入式存储迈入新时代

三星电子又宣布，已经全球第一家商业化规模量产eMRAM(嵌入式磁阻内存)，而且用的是看上去有点“老旧”的28nm FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)成熟工艺，可广泛应用于MCU微控制器、IoT物联网、AI人工智能领域。三星指出，基于放电存储操作的eFlash(嵌入式闪存)已经越来越难以进步，SLC、MLC、TLC、QLC、OLC一路走来，密度越来越高，但是寿命越来越短，主控和算法不得不进行越来越复杂的补偿。eMRAM则是极佳的替代者，因为它是基于磁阻的存储，扩展性非常好，在非易失性、随机访问、寿命耐久性等方面也远胜传统RAM。

来源：电子工程世界

苹果加强数据芯片自主研发

苹果公司周三宣布，未来三年将在圣地亚哥的一个办公室招聘1200名员工，试图在其目前的法律对手高通的地盘上扩大影响力。苹果扩张之际，两家公司仍在进行一场跨国法律战。高通指控苹果侵犯了其专利，而苹果则指控高通在设备中使用其芯片的专利使

用费过高。路透社上月报道称，苹果已将其调制解调器芯片工程团队从供应链部门转移到内部硬件技术部门，这表明苹果可能正在考虑将其过去从高通购买的芯片转向由自己研发生产。苹果最近停止使用高通制造的调制解调器，转而使用英特尔芯片。

来源：新浪网

2019年中国功率半导体市场规模逾2,900亿元，需求持续扩张

全球市场研究机构集邦咨询在最新《中国半导体产业深度分析报告》中指出，受益于新能源汽车、工业控制等终端市场需求大量增加，MOSFET、IGBT等多种产品持续缺货和涨价，带动了2018年中国功率半导体市场规模大幅增长12.76%至2,591亿元人民币。其中功率分立器件市场规模为1,874亿元人民币，较2017年同比增长14.7%；电源管理IC市场规模为717亿元人民币，较2017年同比增长8%。

来源：集邦咨询 TrendForce

风险提示

下游需求不及预期、宏观环境边际恶化。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
减持		相对同期基准指数跌幅在10%以上	

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区锦什坊街35号南楼

邮编：100033

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路868号保利One56 10层

邮编：200120

电话：021-38934111

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com